

мини ПФЭ 100 / 200

Прецизионная физическая чистая ячейка



Оборудование для непрерывной автоматической обработки верхней и нижней поверхностей полосовых заготовок

Маленькая ячейка с широким пистолетом используется в электротехнической промышленности, такой как печатные платы или полупроводники. Равномерно обрабатывая обе стороны, он может применяться для формы стержня и формы листа. Подходит для керамических и медных пластин.

Особенность

- Функции интегрированы, но качество гидроабразивной обработки остается прежним. Недавно разработанная ячейка как небольшая и экономичная цель.
- Компактные детали для струйной очистки и промывки водой облегчают техническое обслуживание приводов; просто открывая крышку конвейера. Кроме того, широкий пистолет и насос, как основные детали, по-прежнему сохраняют первоначальную высокую прочность.
- Модельный ряд из 2-х типов (мини PFE 100/200) в зависимости от размера заготовки.

Спецификация

мини ПФЭ 100

Размер	1200(Ш)×1250(Г)×1600(В)мм
Размер работы	Ширина: 20-100 мм Длина: 100-250 мм Толщина: 0,1-1,5 мм
Транспортная скорость конвейера	0,1□3,0 м/мин
Пистолет	Wide Пистолет 110 мм По одному сверху и снизу
Источник питания	200 В переменного тока, 50/60 Гц, 3 фазы
Потребляемая мощность	Около 2,6 кВт (общая номинальная полная мощность всего оборудования)
Давление подачи воздуха	0,5 МПа-0,7 МПа
Расход воздуха	4,1 м ³ /мин (NTP при заданном давлении дутья 0,25 МПа)

мини ПФЭ 200

Размер	1200(Ш)×1650(Г)×1650(В)мм
Размер работы	Ширина: 20-200 мм Длина: 100-250 мм Толщина: 0,1-1,5 мм
Транспортная скорость конвейера	0,1□3,0 м/мин
Пистолет	Wide Пистолет 220 мм По одному сверху и снизу
Источник питания	200 В переменного тока, 50/60 Гц, 3 фазы

Потребляемая мощность

Около 4,3 кВт (общая номинальная полная мощность всего оборудования)

Давление подачи воздуха

0,5 МПа-0,7 МПа

Расход воздуха

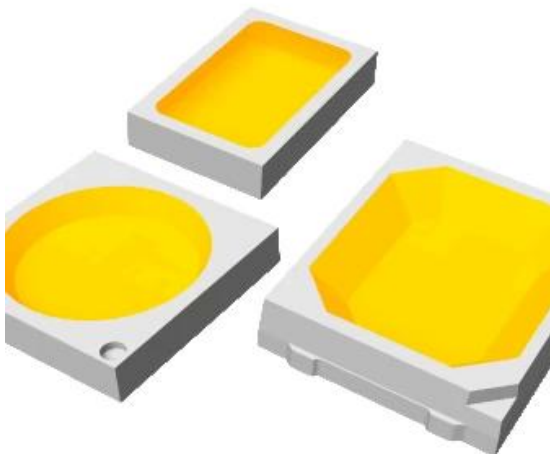
7,7 м³/мин (NTP при заданном давлении дутья 0,25 МПа)

Связанные страницы

Связанные приложения



Предварительная обработка для удаления заусенцев без повреждения полупроводников (удаление заусенцев)



Метод удаления избыточной смолы, который значительно снижает повреждение скрытых светодиодных чипов



Метод обработки для удаления тонких заусенцев (заусенцев) без повреждения корпуса светодиода